

258361

18 MAY



258361

P A T E N T E
D E
I N T R O D U C C I O N

a favor de Don ANGEL HERNANDEZ LOPEZ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Farigola, 2^o, por "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UN BARNIZ SEMICONDUCTOR FLEXIBLE Y ADHERENTE".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un procedimiento para la preparación de un barniz semiconductor flexible y adherente, el cual resulta especialmente apto para recubrimientos de estas características sobre

5. hojas de caucho, materiales sintéticos, papel, tejido o similar, con vistas a la obtención de una pantalla electrostática igualadora de potencial.

Tales barnices deben ser de secado rápido, viscosidad apropiada al procedimiento de aplicación, y de

10. características tales que formen, después de la evapo-

258361

18 MAY



ración del disolvente, una película seca semiconductora, flexible y adherente, que no reblandezca a temperaturas inferiores a los 150° C.

5. De acuerdo con el procedimiento objeto de la invención es posible obtener un barniz de estas características, basándose la invención en la utilización como producto de base de un copolímero vinílico, preferentemente un copolímero de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, plastificado mediante un producto pesado, cargado con negro de acetileno semiconductor y disuelto en un disolventes.

10. De acuerdo con la invención, el barniz en cuestión se prepara, pues, utilizando un 15 a 20% de un copolímero vinílico, plastificado mediante 1,5 a 3,5% de un producto pesado tal como el fosfato de tricresilo u otro plastificante análogo, el cual es cargado con un 6 a 10% de negro de acetileno semiconductor y disuelto en un disolvente tal como la metiletilcetona, en cantidad complementaria para 100 partes.

15. La preparación en sí se lleva a cabo disolviendo el copolímero en presencia de su plastificante en el disolvente. Cuando se ha logrado una solución bien homogénea, lo que puede lograrse llevando a cabo la disolución en un agitador de palas helicoidales, se añade el negro de acetileno y se agita hasta consistencia homogénea, resultando de ello un producto de viscosidad del orden de 50 a 200 centipoises a 20° C. Para el refinado, el barniz se pasa por un molino de pintura o

18 MAY



258361

por un homogenizador del tipo de rotores cónicos.

El barniz así obtenido puede aplicarse por cualquiera de los métodos usuales de pincel, pistola aerográfica, inmersión, etc., siguiendo las técnicas conocidas.

5.

Serán independientes del objeto de la invención los materiales utilizados como base, siempre que se ajusten al tipo indicado, disolventes, cargas y plastificantes, aplicaciones ulteriores de los barnices y, en general, todos cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre que no aparten al conjunto de su esencialidad.

10.

- . -

NOTA

Se reivindica como objeto de la presente patente de introducción:

15.

1. Procedimiento para la preparación de un barniz semiconductor flexible y adherente, que consiste esencialmente en partir como producto básico de un copolímero vinílico, el cual es disuelto, en un 15 a 20% en peso, en un disolvente tal como la metiletilcetona o similar, y en presencia de un 1,5 a 3,5% en peso de un plastificante tal como el fosfato de tricresilo, cuyo plastificante se carga con un 6 a 10% en peso de negro de acetileno semiconductor, utilizándose la cantidad

20.

258361

18 MAY



de disolvente necesaria para completar las 100 partes en peso del conjunto.

2. Procedimiento para la preparación de un barniz semiconductor flexible y adherente, según la reivindicación anterior, que, se caracteriza por el hecho de que la mezcla inicial del copolímero vinílico y el disolvente es agitada convenientemente, hasta lograr una solución homogénea, antes de la adición del plastificante cargado con negro de acetileno, tras de lo cual
- 5.
10. se prosigue la agitación hasta lograr una consistencia homogénea, con viscosidad del orden de 50 a 200 centipoises, pasándose a continuación a un refinado del producto en un aparato apropiado.

3. Procedimiento para la preparación de un barniz semiconductor flexible y adherente.
- 15.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 18 de mayo de 1960.

Angel HERNANDEZ LOPEZ

p.a.